



2025年3月期 第2四半期 決算説明資料

東証スタンダード 証券コード：6614

2024年11月11日

売上高および各利益とも低調で減収・減益

- 今第2四半期の売上高は、電子システム事業の売上の落ち込みが大きく、計画比及び前期比ともに低調な結果となる。マイクロエレクトロニクス事業及び製品開発事業については前期比僅かながら減収となるも堅調に推移。
- 利益は人員増及びベースアップによる労務費増加や新基幹システム稼働による償却費発生、前年同期では発生がなかった福島事業所の経費の発生等によりコストが大きく増加し、営業利益・経常利益ともに前年比大幅減益となるも、通期予想に対する進捗はほぼ予想通りの実績で推移。

(単位：百万円、%)

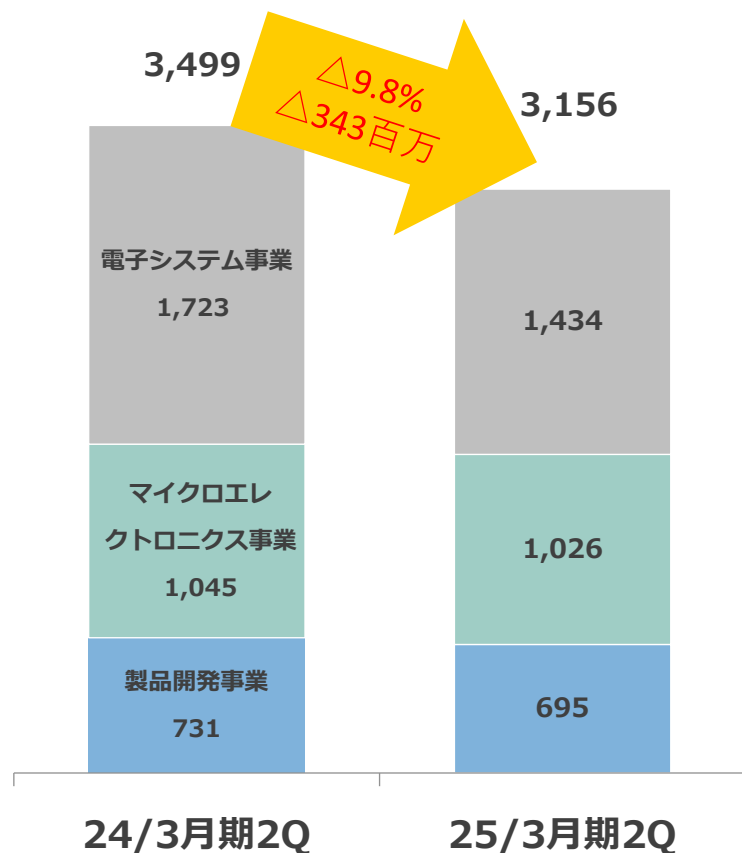
	2025/3期 通期予想		2025/3期 2Q実績 (累計)		通期予想比	前年同期比	
	金額	構成比	金額	構成比	進捗率	増減率	増減額
売上高	7,475	100	3,156	100	42.2	△9.8	△343
販管費	1,424	19.1	622	19.7	43.7	6.3	36
営業利益	385	5.2	24	0.8	6.2	△93.1	△324
営業利益率	5.2		0.8			△9.2	
経常利益	380	5.1	21	0.7	5.7	△93.9	△333
当期純利益	270	3.6	17	0.6	6.6	△92.8	△230

1Qに引き続き、車載用半導体の市場在庫充足による生産調整局面の中、バーインボードを中心とする半導体後工程商材の受注が大きく落ち込み、電子システム事業が大幅減収。

マイクロエレクトロニクス事業、製品開発事業は前期比微減となるも堅調に推移。

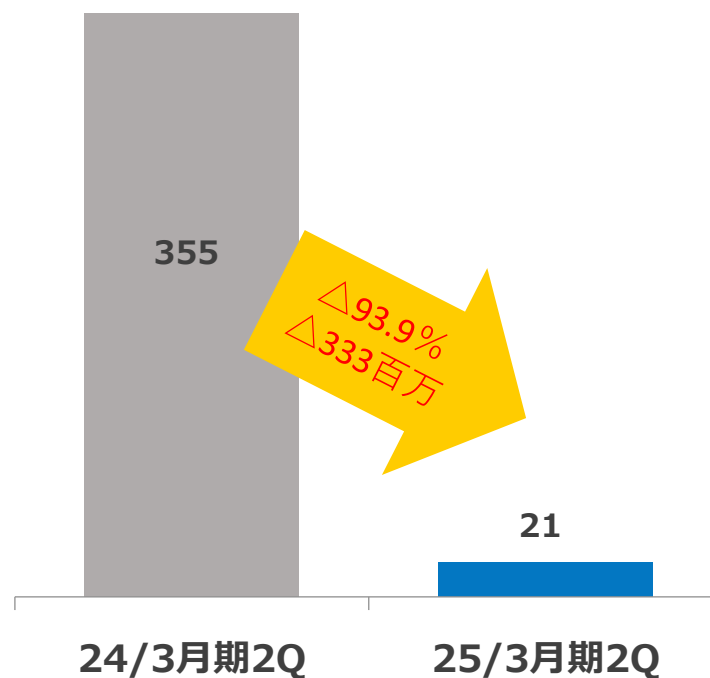
【売上高】

(単位：百万円)



【経常利益】

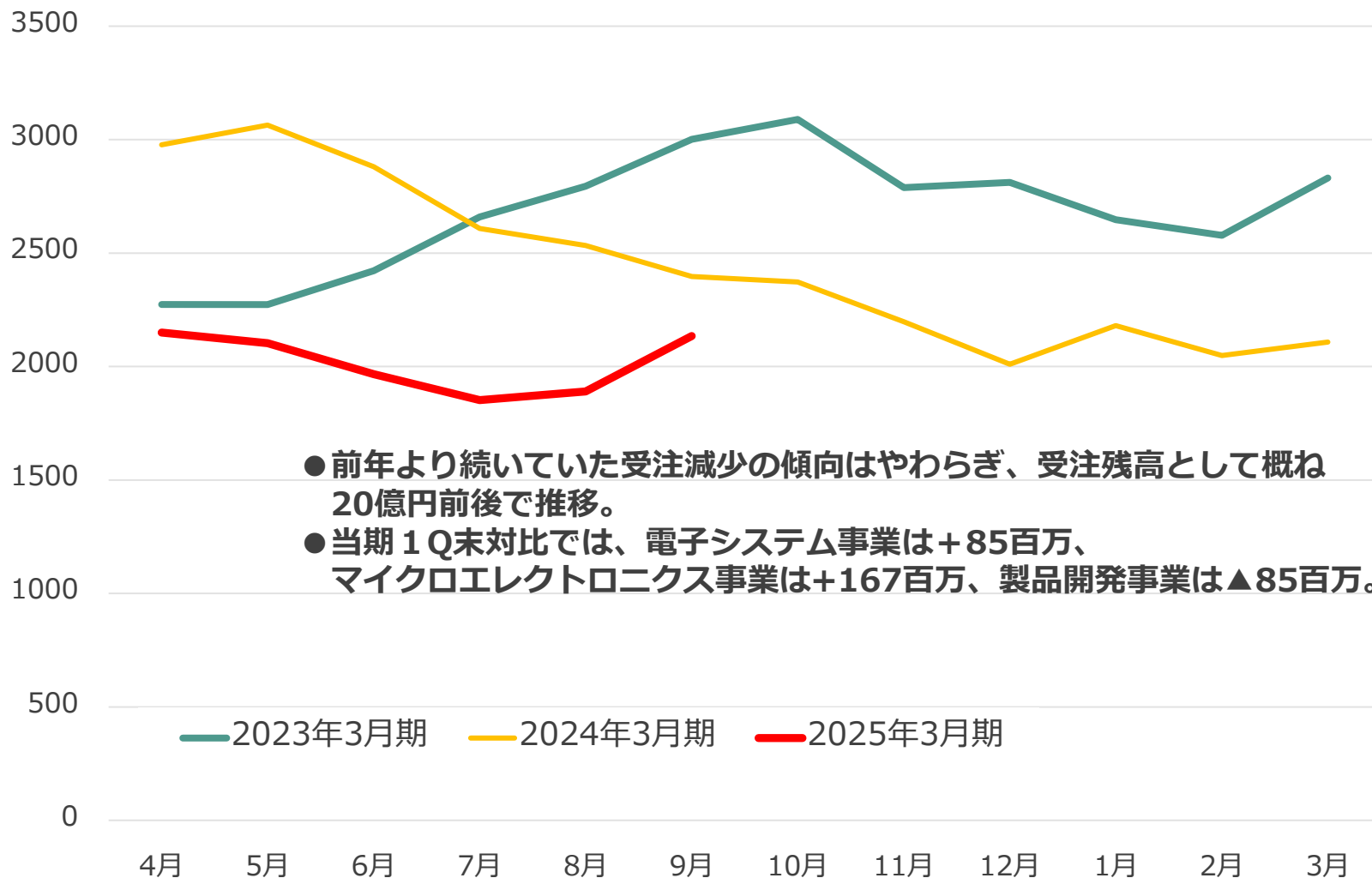
(単位：百万円)



※売上高・経常利益とも前期比で減収減益。

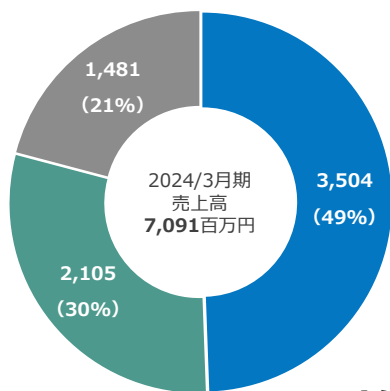
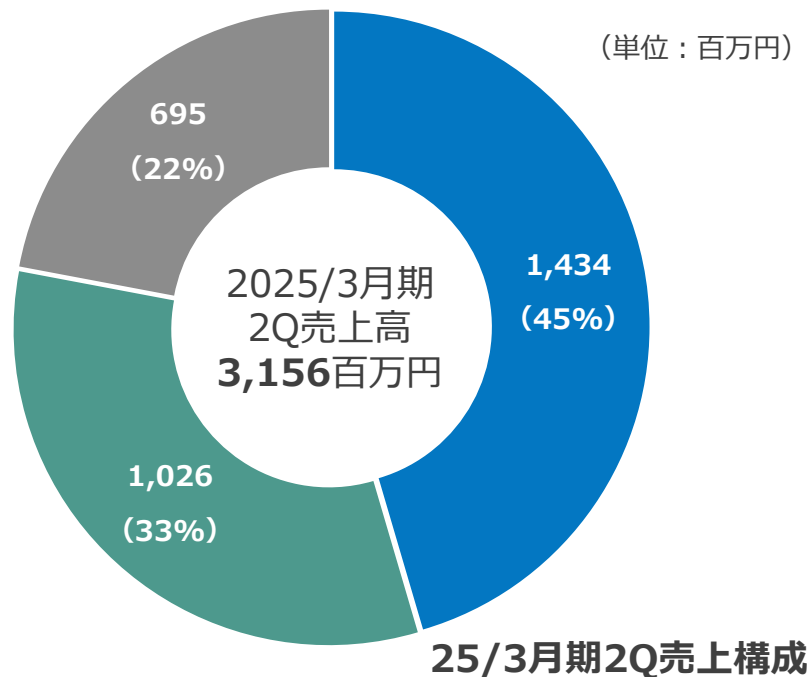
【受注残高（全社）】

（単位：百万円）



- 前年より続いていた受注減少の傾向はやわらぎ、受注残高として概ね20億円前後で推移。
- 当期1Q末対比では、電子システム事業は+85百万、マイクロエレクトロニクス事業は+167百万、製品開発事業は▲85百万。

— 2023年3月期 — 2024年3月期 — 2025年3月期



(参考) 24/3月期売上構成

電子システム事業

半導体検査・装置関連

バーンイン装置、バーンイン装置レンタル、バーンインボード、半導体部品の検査ボード、半導体のテストプログラム、高速通信機器、各種電子機器検査用ボード、専用計測器、電子機器の開発・設計・製造

マイクロエレクトロニクス事業

LSI設計（アナログ・デジタル）、IPコア

電源IC設計、高速I/F設計、イメージセンサ設計、画像処理系LSI設計、FPGA設計、ASIC設計、技術者派遣、JPEG、MIPI、ISP

製品開発事業

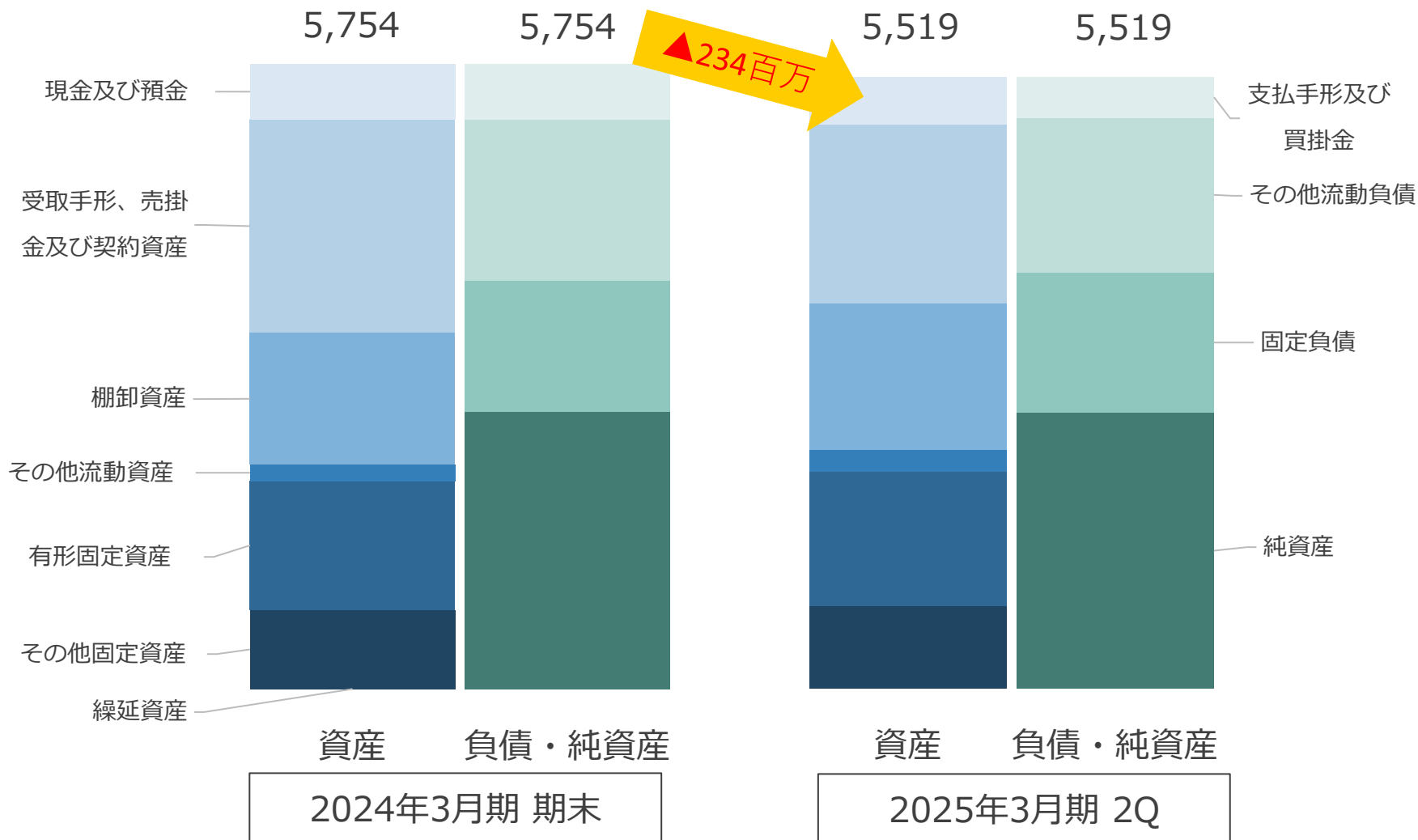
製品開発事業

画像関連機器、CMOSカメラモジュール、画像処理システム、画像処理モジュール

【流動資産】 現預金の減少並びに減収により売上債権が減少。

【流動負債】 仕入債務の減少並びに課税所得減により未払法人税等減少。

【純資産】 利益剰余金の減少により純資産減少。自己資本比率45.1% +0.8ポイント。



2024年

4月 12日 当社技術に関する記事掲載
(無人探査機「SLIM (スリム)」に、当社画像処理技術が搭載)

5月 11日 決算発表
剰余金の配当

5月 29日 太陽光発電による再生可能エネルギー (オフサイトPPA)の採用

6月 12日 決算説明会
神奈川県横浜市中区に神奈川事業所を設置・事業開始

6月 19日 ルネサスエレクトロニクスのプリファード・パートナーに参画

6月 25日 第52期 定時株主総会
とやま介護テクノロジー普及・推進センターにて、センサー+カメラ一体型見守りシステム「C-エイド」常設展示開始

7月29日 ルネサスIPライセンスパートナーに加入

8月23日 宇宙航空研究開発機構 (JAXA) 様より感謝状を受領

8月28日 ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社様より
「Contribution Award」を受賞

10月16日 くまもと3D連携コンソーシアムに入会のお知らせ

11月6日 半導体検査装置の海外向け製品の販売を開始

1Q

2Q

3Q

SLIM感謝状受領

航法カメラFPGA開発

JAXA ISAS様より、
小型月着陸実証機
(SLIM)プロジェクト
貢献を評価され、
感謝状受領

宇宙用通信制御、
JPEG-IPに依る画像圧縮等
で月ピンポイント着陸に
寄与



坂井プロジェクトマネージャーより、
感謝状受領



神奈川事業所開所

開発拠点および営業拠点として稼働開始



桜木町駅徒歩3分の好立地

ミニショールーム併設



くまもと3D連携コンソーシアム入会

三次元積層実装の研究開発の推進

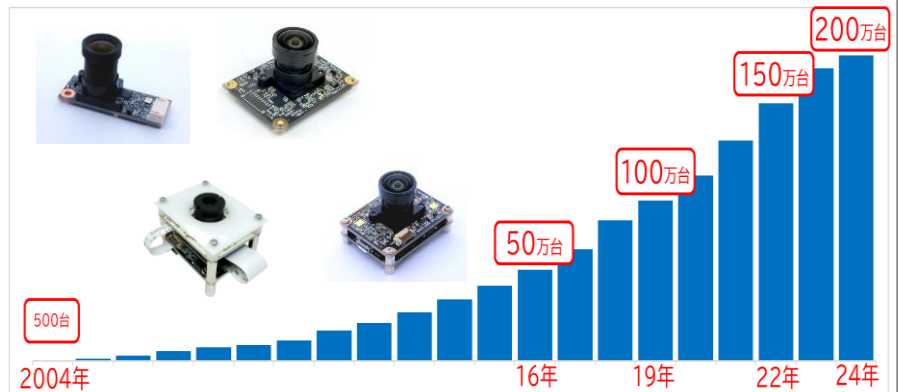
- ・現在120社以上の県内外企業が入会
- ・技術的情報、施策、各社との情報共有、
取組を強化



くまもと3D連携コンソーシアム
34 株式会社神奈川製鋼所
35 有限会社小島アスチック工業
36 ゼイハイシステム株式会社
37 有限会社東洋石炭工業所
38 株式会社神奈川
39 株式会社S&M C/D
40 株式会社サンテック
41 株式会社サンフハイテック
42 シーエムエム株式会社
43 ジーエムエム株式会社
44 株式会社コアソフト
45 株式会社ICP
46 株式会社シキノハイテック
47 株式会社システムエス
48 株式会社システムテック
49 Japan Advanced Semiconductor Manufacturing 株式会社

入会状況

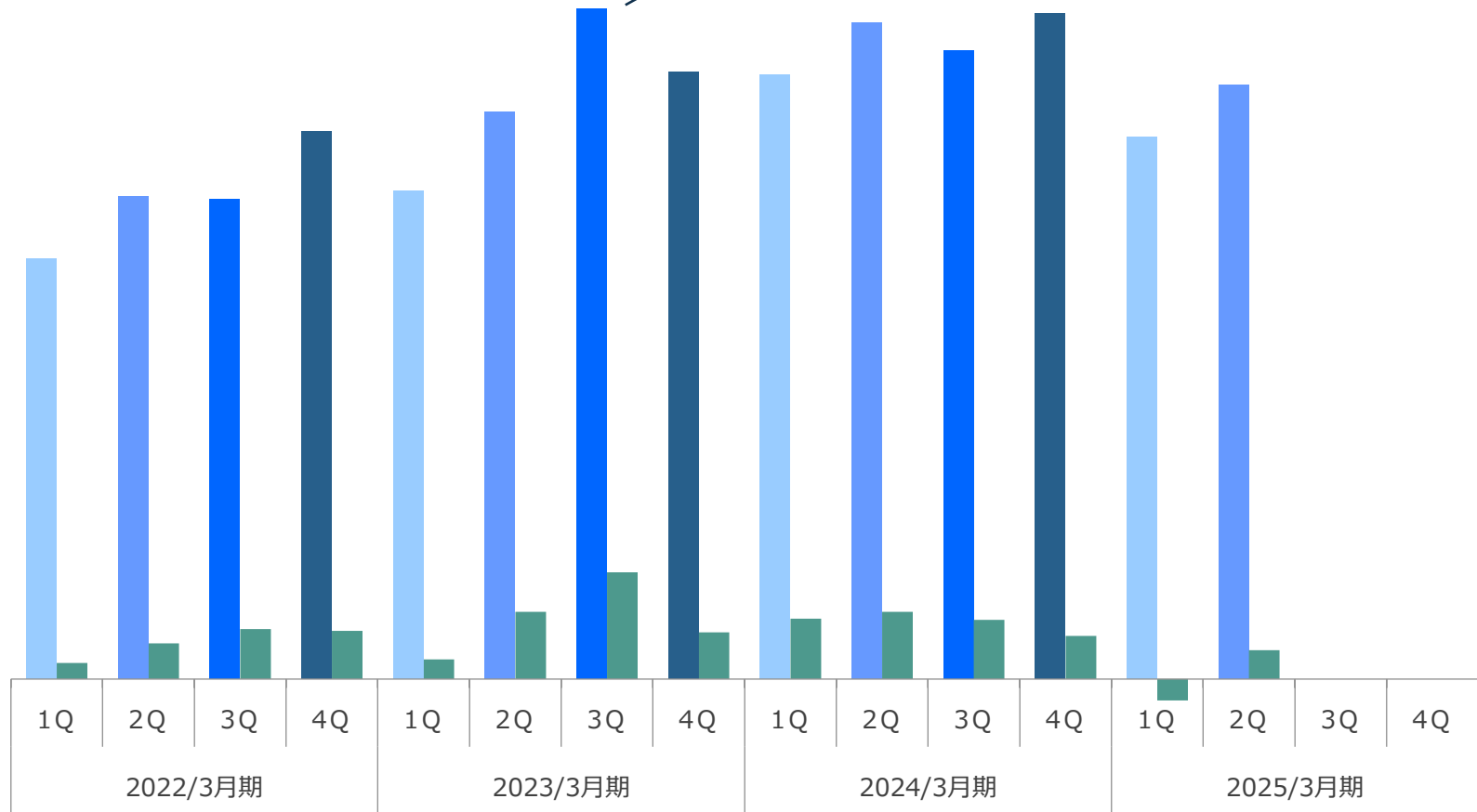
カメラモジュール製品 出荷累計200万台を突破



決算状況③ 四半期業績推移

■ 1Q売上高 ■ 2Q売上高 ■ 3Q売上高 ■ 4Q売上高
■ 経常利益

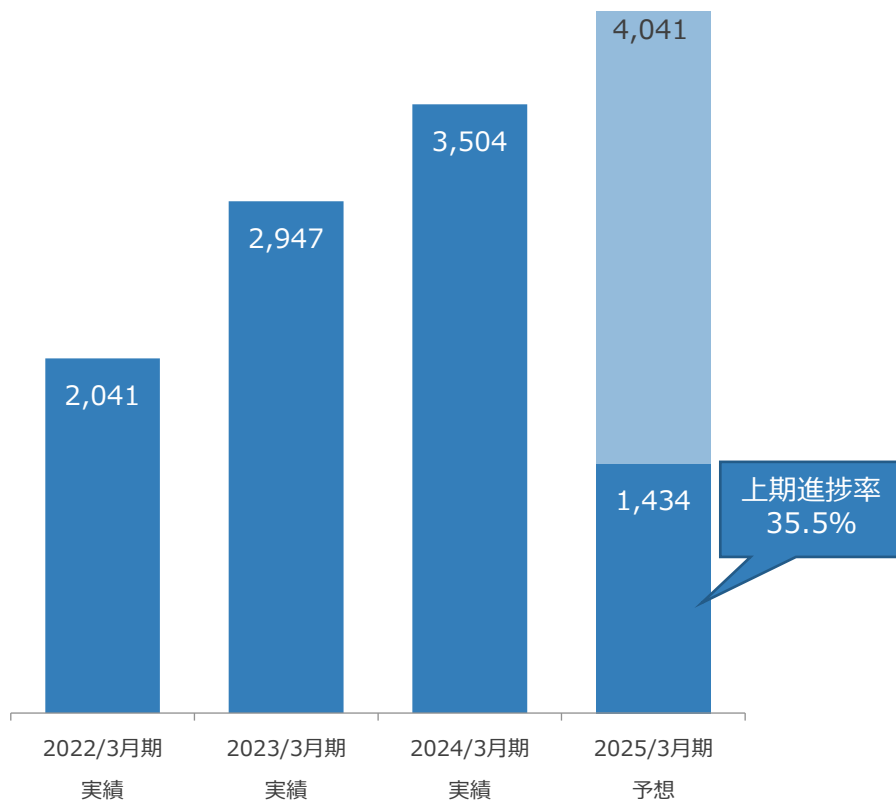
マイナンバーカード推進に伴う
カメラ応用機器が特需的に増加



車載半導体は市場在庫過多による各社生産調整強化継続中で顧客設備投資が急減。
 パワー半導体・センサー向けのカスタムバーンイン装置は、前年の生産設備拡充完了により所要減。
 車載用専用計測機器は顧客の海外拠点の生産ライン向けで受注台数及び周辺機器の受注増加。

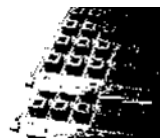
【売上高】

(単位：百万円)



上期トピックス

▶ 半導体装置検査装置の受注がけん引



バーンインボード
 前年同期比：50%



半導体検査装置販売・リース
 前年同期比：25%



車載製品用専用計測機器関連
 前年同期比：116%

SONY様より表彰状受領
 開発計画+コスト改善への貢献



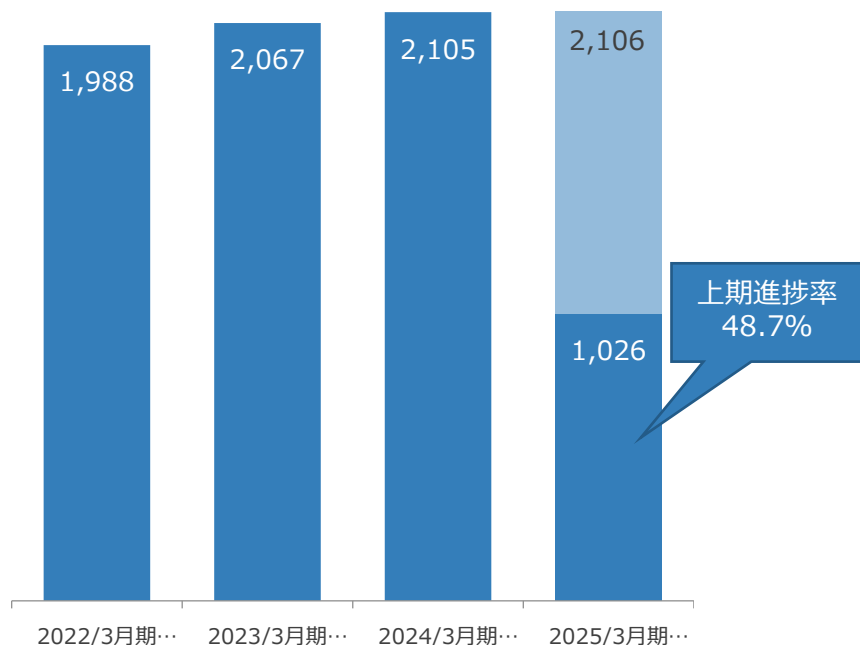
バーンイン装置の海外出荷
 世界大手の台湾OSAT
 メーカー向けに初受注・
 初出荷



アナログは自動車向けパワー半導体設計が好調、センサー用半導体は受注は堅調だがリソースのミスマッチにより前年から減少。デジタルは、自動車向け設計受託に注力。

【売上高】

(単位：百万円)



上期トピックス

➤ アナログ半導体設計受託

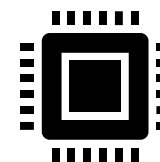
自動車向け等パワー半導体
前年同期比：128%



センサー用半導体
前年同期比：78%



➤ アナログIPなど自社商品
ラインナップ強化に向け
試作チップの開発、評価が順調。



➤ デジタル半導体設計受託

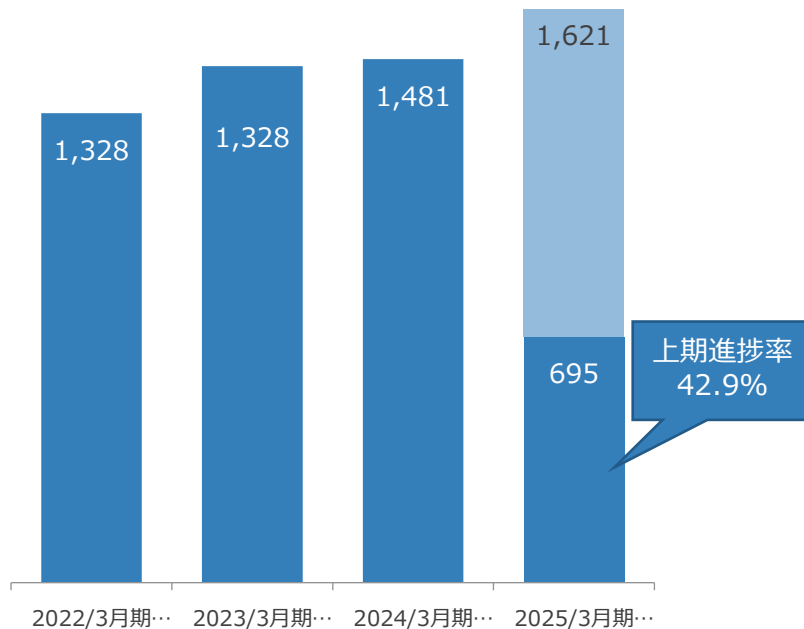
自動車関連デジタル設計
前年同期比：102%



海外ATM・POSシステム向けビューカメラの一部需要減少や受託が軟調も医療検体装置、カードゲーム、家庭用ロボット向けの医療・民生向けセンシングカメラは好調。

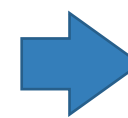
【売上高】

(単位：百万円)

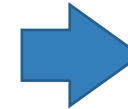


上期トピックス

- 製品種では画像センシングカメラが牽引



ビューカメラ
前年同期比:87%



画像センシングカメラ
前年同期比:168%

- 欧州顧客に出荷開始
 - Embedded World (ドイツ) 出展
 - ドアホン向けカメラを欧州に初出荷



- ルネサス エレクトロニクス
プリファード・パートナーに参画

- 見守りシステム
 - 「C-エイド」商標登録完了
 - とやま介護テクノロジーセンター常設展示開始



- カメラモジュール製品
 - 出荷累計200万台を突破

下期業績見直しを見直し、売上高及び利益ともに下方修正

売上高10.2%減、営業利益59.7%減、経常利益60.5%減、当期純利益51.9%減を予想

- バーインボードの受注回復に力強さが見られず、また前期事業譲受した福島事業所での民生機器向けEMS事業が大幅に減収、製品開発事業のカメラ製品も減収となる見込みから売上高を下方修正
- 経費削減するも売上減少に伴う利益減を補えず、営業利益、経常利益、当期純利益とも下方修正

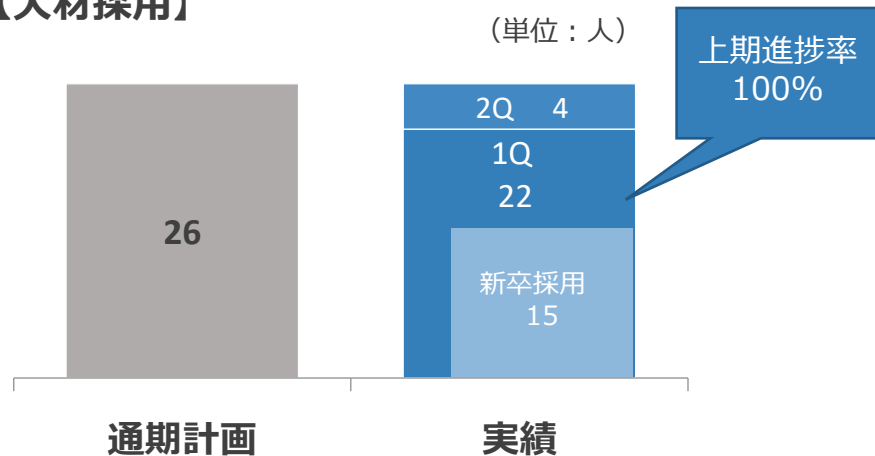
(単位：百万円、%)

科目	2025/3期 通期予想		2025/3期 修正予想		当初計画比	
	金額	構成比	金額	構成比	増減	増減率
売上高	7,475	100	6,715	100	△760	△10.2
営業利益	385	5.2	155	2.3	△230	△59.7
経常利益	380	5.1	150	2.2	△230	△60.5
当期純利益	270	3.6	130	1.9	△140	△51.9

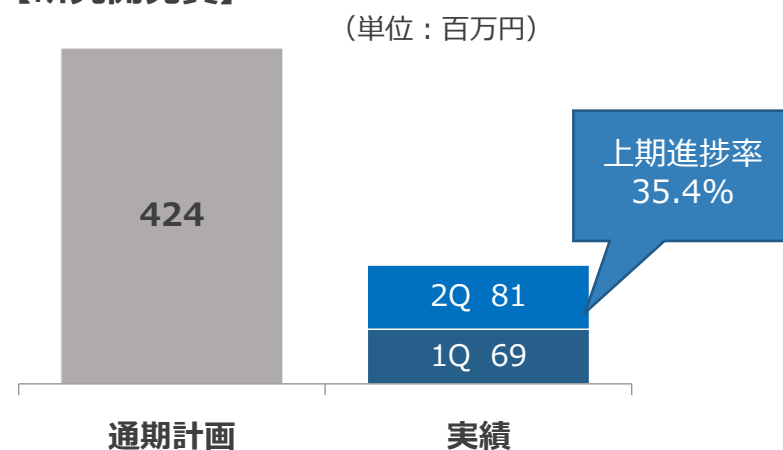
人材採用の進捗率としては順調に推移するも、人材争奪戦の激化は継続。

研究開発費は直近の販売に結び付く重要テーマに絞った一部計画見直しにより進捗率未達

【人材採用】



【研究開発費】



主要開発テーマ

電子システム事業

- ・半導体検査装置・カスタム検査装置
- 次世代IoT-PLC通信モジュール

マイクロエレクトロニクス事業

- ・次世代JPEG IPコア・画像処理ISP IPコア・アナログIP

製品開発事業

- ・カメラモジュールラインナップ増強・
- 次世代エッジAIカメラシステム開発・介護向けシステム製品化開発

本資料で提供する情報のうち業績見通しおよび事業計画等に関するものは、当社が現時点で入手可能な情報と合理的であると判断する一定の前提に基づいており、リスクや不確実性を含んでおります。

従って、実際の業績は、様々な要因により、これらの見通しとは異なる結果になりうることをご承知おきください。

当社がこの資料を発行後、適用法令の要件に服する場合を除き、将来に関する記述を更新、又は修正して公表する義務を負うものではありません。

本資料に含まれる当社以外に関する情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性、適切性等について当社は何らの検証も行っておらず、又これを保証するものではありません。

本資料の著作権は当社に帰属し、目的を問わず、当社に事前の承諾なく複製又は転用することなどを禁じます。

ご注意事項

数字の処理について

当社業績に関する記載金額は特に明記が無い限り、以下の通り処理しております。そのため内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- ・表、グラフの金額：表示単位未満を切り捨て
- ・比率：表示単位第1位未満を四捨五入

お問い合わせ先

株式会社シキノハイテック

取締役管理本部長 舩田 敏彰

e-mail : IR-contact@shikino.co.jp

TEL : 0765-22-3477 FAX : 0765-22-3916

ホームページ : <https://www.shikino.co.jp/>